



SOITEC ANNONCE LA PRODUCTION EN VOLUME DE SUBSTRATS RF-SOI EN 300 MM POUR REpondre A LA CROISSANCE DES MARCHES DES COMMUNICATIONS MOBILES 4G/LTE-ADVANCED

Bernin (Grenoble), France, le 18 février 2016 — Soitec (Euronext), leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants et fournisseur de substrats en silicium sur isolant destinés aux applications de radiofréquence (substrats « RF-SOI »), a commencé à produire en volume des plaques de RF-SOI dans un diamètre de 300 mm, pour le marché des communications mobiles. La production en 300 mm du substrat RFeSI90 de Soitec a été rendue possible par l'utilisation des technologies brevetées de l'entreprise, par son expertise dans le domaine des substrats RF-SOI en diamètre de 200 mm et par son expérience en matière de production en volume de plaques en 300 mm. Ces substrats innovants vont permettre de produire davantage de circuits à haut niveau d'intégration pour les réseaux 4G/LTE-Advanced et pour la prochaine génération de technologies de l'Internet mobile, dont la 5G.

Cette annonce intervient au moment même où Soitec passe le cap d'un million de plaques RF-SOI de 200 mm vendues depuis 2009. Cette étape clé souligne le rôle central du RF-SOI sur le marché des communications sans fil, qui est en plein essor. Le million de plaques RF-SOI fabriquées et expédiées par Soitec a permis la production d'environ 20 milliards de circuits intégrés pour les modules RF (les « Front End Modules »). Les substrats RF-SOI de Soitec font désormais partie intégrante des commutateurs et des adaptateurs d'antenne, certains amplificateurs de puissance et des circuits WiFi, car ils répondent aux exigences de performance des circuits intégrés utilisés dans les smartphones. Ces matériaux ont été largement adoptés par les principaux fabricants de semi-conducteurs dédiés à la radiofréquence, qui peuvent grâce à eux répondre aux besoins de coût, de performance et d'intégration des applications mobiles sans fil de la 3G et de la 4G / LTE.

« La généralisation des matériaux et de la technologie de Soitec dans les produits mobiles 3G et 4G actuels démontre l'importance du RF-SOI pour pouvoir produire en volume et à un coût compétitif des téléphones cellulaires, des tablettes et d'autres équipements de l'internet mobile, qui représentent des marchés en forte croissance » indique Bernard Aspar, Vice-président de la Business Unit Communication & Power de Soitec. *« Désormais, la possibilité de produire en masse nos substrats RF-SOI en 300 mm va aider nos clients, et les clients de nos clients, à continuer à offrir de plus en plus de performance, tout en leur donnant accès à davantage de capacités chez les grandes fonderies, en leur offrant une flexibilité de production accrue ».*

Soitec fabrique et vend depuis de nombreuses années d'importants volumes de substrats RF-SOI en 200 mm et continue à accroître sa capacité de production pour les plaques de ce diamètre. Depuis dix-huit mois, l'entreprise livre également des échantillons de substrats eSI90 RF en 300 mm en vue de la qualification de ce nouveau produit. Les partenariats conclus par Soitec avec des fonderies et sociétés de conception de puces (dites « fabless ») ont été déterminants pour franchir avec succès les grandes étapes de la mise en production. Ils ont permis d'atteindre les niveaux de performance qui caractérisent aujourd'hui les produits RF-SOI en 300 mm. En rendant possible un approvisionnement en volume de substrats RF-SOI en 300 mm, Soitec permet à ses clients d'accroître leurs capacités de production de puces RF-SOI et de circuits à haut niveau d'intégration.

Ces nouveaux substrats – basés sur un procédé SOI plus avancé – présentent des niveaux de performance plus élevés et une meilleure uniformité, un paramètre clé pour mieux contrôler l'appariement des transistors lors de la conception des semi-conducteurs analogiques. Cela permet de concevoir des transistors plus fins et d'accéder à d'autres options de fabrication pour améliorer la performance $R_{on}C_{off}$, le facteur de mérite qui est utilisé pour évaluer la performance d'un commutateur RF.

Soitec poursuit ses travaux sur les futures générations de substrats RF-SOI. Sa feuille de route doit permettre aux futurs marchés de la communication mobile d'atteindre de nouveaux seuils en termes d'innovation et de rapport coût-efficacité.

A propos de Soitec: Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique et de l'énergie. Avec 3600 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter:

Presse Soitec :

Marylen Schmidt
+33 (0)6 21 13 66 72
marylen.schmidt@soitec.com

Relations Investisseurs Soitec :

Steve Babureck
[+33 \(0\)6 16 38 56 27](tel:+330616385627)
[+1 858 519 6230](tel:+18585196230)
steve.babureck@soitec.com

###